

# 46-416 Economy Version

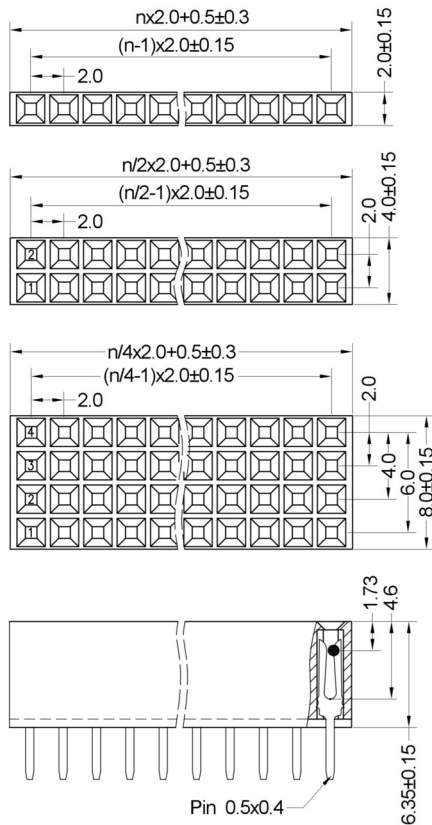
Buchsenleisten RM 2,00mm, gerade/gewinkelt, 1-/2-/4-reihig - BH 6,35mm  
 Female Headers, 2.00mm Pitch, Straight/Right-Angled, 1/2/4 Rows – 6.35mm Profile

## Technische Daten / Technical Data

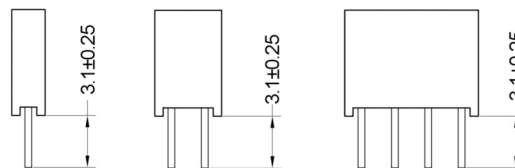
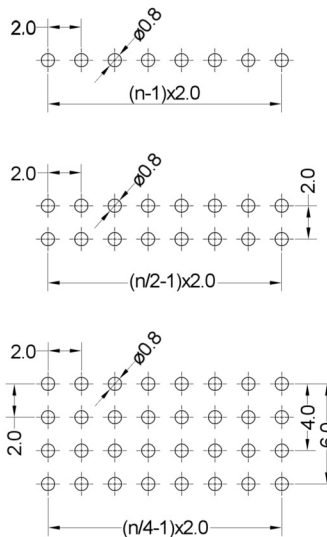
Isolierkörper	Thermoplast, nach UL94 V-0
Insulator	Thermoplastic, rated UL94 V-0
Kontaktmaterial	Kupferlegierung
Contact Material	Copper alloy
Kontaktfläche	Au über Ni
Contact Surface	Au over Ni
Durchgangswiderstand	< 20 mΩ
Contact Resistance	< 20 mΩ
Isolationswiderstand	> 1000 MΩ
Insulation Resistance	> 1000 MΩ
Spannungsfestigkeit	500 V AC/DC
Test Voltage	500 V AC/DC
Nennstrom	1,5 A
Current Rating	1.5 A
Temperaturbereich	-40 °C ... +105 °C
Temperature Range	-40 °C ... +105 °C
Verarbeitung	230 °C für 30-60 Sekunden (260 °C für 10 Sekunden)
Processing	230 °C for 30-60 seconds (260 °C for 10 seconds)



Gabelkontakte für Vierkantstifte 0,50mm.  
 Fork contacts accept 0.50mm square pins.



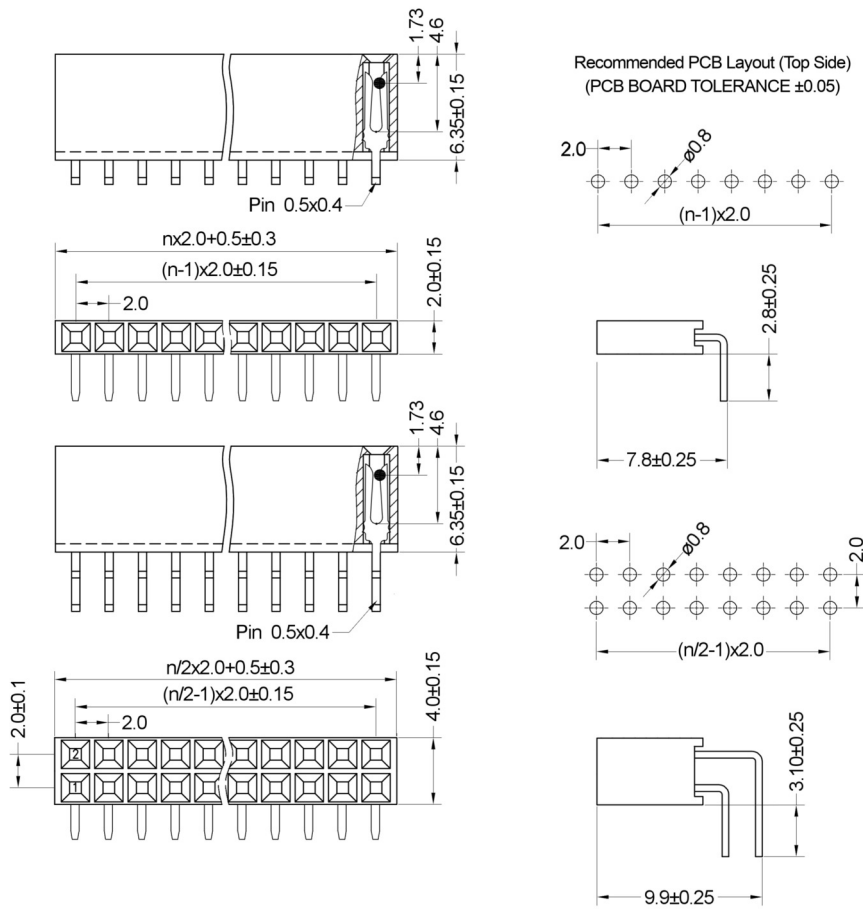
Recommended PCB Layout (Top Side)  
 (PCB BOARD TOLERANCE ±0.05)



Series	Contacts*	Rows*	Type	Dimensions	Plating
<b>46-416</b>	<b>020</b> 002-040 Einreihig Single row 004-080 Zweireihig Double row 008-160 Vierreihig Four row	<b>1</b> 1 Einreihig Single row 2 Zweireihig Double row 4 Vierreihig Four row	<b>1</b> 1 Gerade Straight	<b>10</b> 10 C=3,1mm	<b>00</b> 00 Vergoldet Gold plated

# 46-416 Economy Version

Buchsenleisten RM 2,00mm, gerade/gewinkelt, 1-/2-/4-reihig - BH 6,35mm  
 Female Headers, 2.00mm Pitch, Straight/Right-Angled, 1/2/4 Rows – 6.35mm Profile



Series	Contacts*	Rows*	Type	Dimensions	Plating
<b>46-416</b>	<b>022</b> 002-040 Einreihig Single row 004-080 Zweireihig Double row	<b>1</b> 1 Einreihig Single row 2 Zweireihig Double row	<b>2</b> 2 Gewinkelt Right-angled	<b>10</b> 10 C=2,8mm (Einreihig) C=3,1mm (Zweireihig) C=2,8mm (Single row) C=3,1mm (Double row)	<b>00</b> 00 Vergoldet Gold plated

\* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -  
 bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.  
 \* This is an **order example** -  
 please replace by your specifications.

### Reflow-Lötempfehlung für kurze Lötzeiten

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum $T_{Smin}$	150 °C
Temperatur Maximum $T_{Smax}$	200 °C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	60 – 180s
Temperatur Lötbereich $T_L$	untere Temperaturangabe [°C]
Verweildauer oberhalb $T_L$	laut Angabe im Datenblatt [sec]
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3 °C / s
Höchsttemperatur $T_P$	obere Temperaturangabe [°C]
Dauer Höchsttemperatur	laut Angabe im Datenblatt [sec]
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6 °C / s
Dauer 25 °C – Höchsttemperatur $T_P$	max. 8m

### Reflow Soldering Recommendation For Shorter Peak Times

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature $T_{Smin}$	150 °C
Maximum Temperatur $T_{Smax}$	200 °C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	60 – 180s
Soldering Range Temperature $T_L$	Lower Temperature [°C]
Duration above $T_L$	Acc. to datasheet [sec]
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3 °C / s
Peak Temperature $T_P$	Upper Temperature [°C]
Duration Peak Temperature	Acc. to datasheet [sec]
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6 °C / s
Duration 25°C - Peak Temp. $T_P$	max. 8min

